

SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Der durchgängige Tragschienenbus für das modulare Elektronikgehäuse-System**

Beim Versorgen, Verbinden und Verteilen in modularen Applikationen ersetzt der Tragschienenbus die aufwändige Einzelverdrahtung durch eine unterbrechnungsfreie und flexible Systemlösung.

Der Systembus ist sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert. Per Reflow-Verfahren lässt sich der SMD-Bus-Kontaktblock bei der Baugruppenfertigung vollautomatisch verarbeiten. Die widerstandsfähigen, vergoldeten Kontaktflächen gewährleisten eine dauerhaft zuverlässige Kontaktierung für alle Gehäusebreiten.

- **Grenzenlose Skalierbarkeit** - die durchgängige Verbindungslösung quer über alle Systembaubreiten - von der 6 mm-Scheibe bis zum 67 mm-Großraumgehäuse.
- **Servicefreundliche Installation** - einfacher Modulwechsel auch im bestehenden Modulverbund ohne Auswirkung auf benachbarte Module.
- **Universelle Integration** - unterbrechnungsfreier Systembus: sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert.
- **Maximale Verfügbarkeit** - Fünf voll-galvanisierte und teil-vergoldete Twinbogenkontakte stellen eine dauerhafte Kontaktierung zum Tragschienenbus sicher. THR-Lötflansche sorgen für eine stabile Verbindung zur Leiterplatte.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, Bus-Kontaktblock für CH20M12-67, Mittellötflansch, THT/THR-Lötanschluss, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, vergoldet, schwarz
Best.-Nr.	1155870000
Typ	SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX
GTIN (EAN)	4032248942510
VPE	78 Stück
Produkt-Kennzahlen	UL: 300 V / 5 A
Verpackung	Box

SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	5,9 mm	Höhe (inch)	0,232 inch
Breite	16,3 mm	Breite (inch)	0,642 inch
Länge	24 mm	Länge (inch)	0,945 inch
Nettogewicht	3,115 g		

Werkstoffdaten

Isolierstoff	LCP	Isolierstoffgruppe	IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI)	175 ≤ CTI <400		

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm	IEC 60664-1, IEC 61984	Bemessungsspannung bei Überspannungs-/Verschmutzungsgrad III/3	63 V
Bemessungs-Stoßspannung für Überspannungsklasse/Verschmutzungsgrad II/3	1,5 kV	Kriechstrecke, min.	3,2 mm
Luftstrecke, min.	2,3 mm		

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus)		Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)	300 V	Nennspannung (Use group C / UL 1059)	50 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059)	50 V	Nennstrom (Use group B / UL 1059)	5 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059)	5 A	Nennstrom (Use group D / UL 1059)	5 A
Hinweis zu den Zulassungswerten	Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-18-27-92

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität	Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
-----------------	--

SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693

Downloads

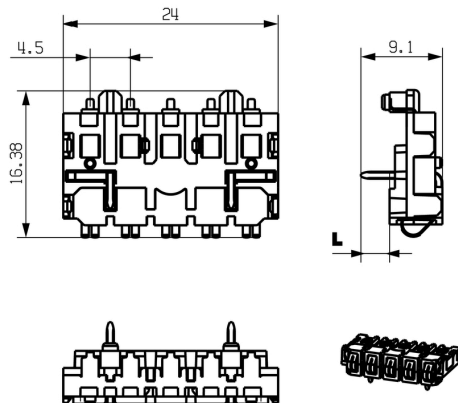
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX

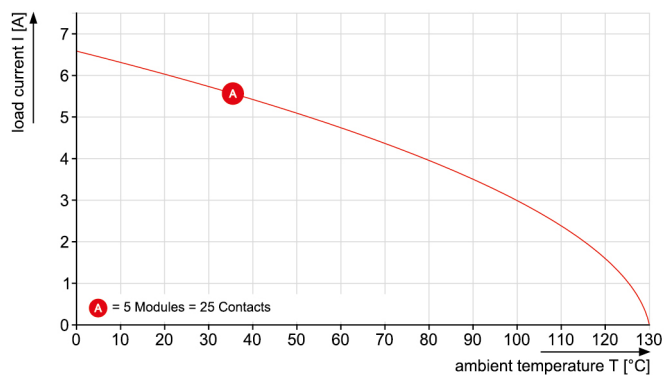
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



CH20M22-Bus



SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

CH20M BUS-AP – Abschlussplatten für Bus-Einsatzprofil

**Der durchgängige Tragschienenbus für das modulare Elektronikgehäuse-System**

Beim Versorgen, Verbinden und Verteilen in modularen Applikationen ersetzt der Tragschienenbus die aufwändige Einzelverdrahtung durch eine unterbrechungsfreie und flexible Systemlösung. Der Systembus ist sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert. Per Reflow-Verfahren lässt sich der SMD-Bus-Kontaktblock bei der Baugruppenfertigung vollautomatisch verarbeiten. Die widerstandsfähigen, vergoldeten Kontaktflächen gewährleisten eine dauerhaft zuverlässige Kontaktierung für alle Gehäusebreiten.

- **Grenzenlose Skalierbarkeit** - die durchgängige Verbindungslösung quer über alle Systembaubreiten - von der 6 mm-Scheibe bis zum 67 mm-Großraumgehäuse.
- **Servicefreundliche Installation** - einfacher Modulwechsel auch im bestehenden Modulverbund ohne Auswirkung auf benachbarte Module.
- **Universelle Integration** - unterbrechungsfreier Systembus: sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert.
- **Maximale Verfügbarkeit** - Fünf voll-galvanisierte und teil-vergoldete Twinbogenkontakte stellen eine dauerhafte Kontaktierung zum Tragschienenbus sicher. THR-Lötflansche sorgen für eine stabile Verbindung zur Leiterplatte.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CH20M BUS-AP RE TS 35X7 ...	Ausführung
Best.-Nr.	1193170000	OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 40.5 mm, Breite: 5.1 mm
GTIN (EAN)	4032248987924	
VPE	50 Stück	
Typ	CH20M BUS-AP LI TS 35X7 ...	Ausführung
Best.-Nr.	1193160000	OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 40.5 mm, Breite: 5.1 mm
GTIN (EAN)	4032248987771	
VPE	50 Stück	

SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Bus-Einsatzprofil – TS35x7.5

**Der durchgängige Tragschienenbus für das modulare Elektronikgehäuse-System**

Beim Versorgen, Verbinden und Verteilen in modularen Applikationen ersetzt der Tragschienenbus die aufwändige Einzelverdrahtung durch eine unterbrechungsfreie und flexible Systemlösung. Der Systembus ist sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert. Per Reflow-Verfahren lässt sich der SMD-Bus-Kontaktblock bei der Baugruppenfertigung vollautomatisch verarbeiten. Die widerstandsfähigen, vergoldeten Kontaktflächen gewährleisten eine dauerhaft zuverlässige Kontaktierung für alle Gehäusebreiten.

- **Grenzenlose Skalierbarkeit** - die durchgängige Verbindungslösung quer über alle Systembaubreiten - von der 6 mm-Scheibe bis zum 67 mm-Großraumgehäuse.
- **Servicefreundliche Installation** - einfacher Modulwechsel auch im bestehenden Modulverbund ohne Auswirkung auf benachbarte Module.
- **Universelle Integration** - unterbrechungsfreier Systembus: sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert.
- **Maximale Verfügbarkeit** - Fünf voll-galvanisierte und teil-vergoldete Twinbogenkontakte stellen eine dauerhafte Kontaktierung zum Tragschienenbus sicher. THR-Lötflansche sorgen für eine stabile Verbindung zur Leiterplatte.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CH20M BUS-PROFIL TS 35X ...	Ausführung
Best.-Nr.	1248150000	OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 250 mm, Breite: 25.1
GTIN (EAN)	4050118053296	mm
VPE	10 Stück	
Typ	CH20M BUS-PROFIL TS 35X ...	Ausführung
Best.-Nr.	1248170000	OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 750 mm, Breite: 25.1
GTIN (EAN)	4050118053272	mm
VPE	5 Stück	
Typ	CH20M BUS-PROFIL TS 35X ...	Ausführung
Best.-Nr.	1248160000	OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 500 mm, Breite: 25.1
GTIN (EAN)	4050118053289	mm
VPE	10 Stück	

SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

CH20M BUS-ADP – Abdeckplatte für Bus-Einsatzprofil

**Der durchgängige Tragschienenbus für das modulare Elektronikgehäuse-System**

Beim Versorgen, Verbinden und Verteilen in modularen Applikationen ersetzt der Tragschienenbus die aufwändige Einzelverdrahtung durch eine unterbrechungsfreie und flexible Systemlösung. Der Systembus ist sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert. Per Reflow-Verfahren lässt sich der SMD-Bus-Kontaktblock bei der Baugruppenfertigung vollautomatisch verarbeiten. Die widerstandsfähigen, vergoldeten Kontaktflächen gewährleisten eine dauerhaft zuverlässige Kontaktierung für alle Gehäusebreiten.

- **Grenzenlose Skalierbarkeit** - die durchgängige Verbindungslösung quer über alle Systembaubreiten - von der 6 mm-Scheibe bis zum 67 mm-Großraumgehäuse.
- **Servicefreundliche Installation** - einfacher Modulwechsel auch im bestehenden Modulverbund ohne Auswirkung auf benachbarte Module.
- **Universelle Integration** - unterbrechungsfreier Systembus: sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert.
- **Maximale Verfügbarkeit** - Fünf voll-galvanisierte und teil-vergoldete Twinbogenkontakte stellen eine dauerhafte Kontaktierung zum Tragschienenbus sicher. THR-Lötflansche sorgen für eine stabile Verbindung zur Leiterplatte.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CH20M BUS-ADP TS 35/250	Ausführung
Best.-Nr.	1248250000	OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 250 mm, Breite: 39.5
GTIN (EAN)	4050118053203	mm
VPE	10 Stück	
Typ	CH20M BUS-ADP TS 35/500	Ausführung
Best.-Nr.	1248260000	OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 500 mm, Breite: 39.5
GTIN (EAN)	4050118052992	mm
VPE	10 Stück	
Typ	CH20M BUS-ADP TS 35/750	Ausführung
Best.-Nr.	1248270000	OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 750 mm, Breite: 39.5
GTIN (EAN)	4050118052985	mm
VPE	5 Stück	

SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

CH20M BUS – Busleiterplatte

**Der durchgängige Tragschienenbus für das modulare Elektronikgehäuse-System**

Beim Versorgen, Verbinden und Verteilen in modularen Applikationen ersetzt der Tragschienenbus die aufwändige Einzelverdrahtung durch eine unterbrechungsfreie und flexible Systemlösung. Der Systembus ist sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert. Per Reflow-Verfahren lässt sich der SMD-Bus-Kontaktblock bei der Baugruppenfertigung vollautomatisch verarbeiten. Die widerstandsfähigen, vergoldeten Kontaktflächen gewährleisten eine dauerhaft zuverlässige Kontaktierung für alle Gehäusebreiten.

- **Grenzenlose Skalierbarkeit** - die durchgängige Verbindungslösung quer über alle Systembaubreiten - von der 6 mm-Scheibe bis zum 67 mm-Großraumgehäuse.
- **Servicefreundliche Installation** - einfacher Modulwechsel auch im bestehenden Modulverbund ohne Auswirkung auf benachbarte Module.
- **Universelle Integration** - unterbrechungsfreier Systembus: sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert.
- **Maximale Verfügbarkeit** - Fünf voll-galvanisierte und teil-vergoldete Twinbogenkontakte stellen eine dauerhafte Kontaktierung zum Tragschienenbus sicher. THR-Lötflansche sorgen für eine stabile Verbindung zur Leiterplatte.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CH20M BUS 4.50/05 AU/750	Ausführung
Best.-Nr.	1248240000	OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Breite: 21.8 mm
GTIN (EAN)	4050118053210	
VPE	5 Stück	
Typ	CH20M BUS 4.50/05 AU/500	Ausführung
Best.-Nr.	1248230000	OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Breite: 21.8 mm
GTIN (EAN)	4050118053227	
VPE	10 Stück	
Typ	CH20M BUS 4.50/05 AU/250	Ausführung
Best.-Nr.	1248220000	OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 250 mm, Breite: 21.8 mm
GTIN (EAN)	4050118053234	
VPE	10 Stück	

SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Bus-Einsatzprofil – TS35x15

**Der durchgängige Tragschienenbus für das modulare Elektronikgehäuse-System**

Beim Versorgen, Verbinden und Verteilen in modularen Applikationen ersetzt der Tragschienenbus die aufwändige Einzelverdrahtung durch eine unterbrechungsfreie und flexible Systemlösung. Der Systembus ist sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert. Per Reflow-Verfahren lässt sich der SMD-Bus-Kontaktblock bei der Baugruppenfertigung vollautomatisch verarbeiten. Die widerstandsfähigen, vergoldeten Kontaktflächen gewährleisten eine dauerhaft zuverlässige Kontaktierung für alle Gehäusebreiten.

- **Grenzenlose Skalierbarkeit** - die durchgängige Verbindungslösung quer über alle Systembaubreiten - von der 6 mm-Scheibe bis zum 67 mm-Großraumgehäuse.
- **Servicefreundliche Installation** - einfacher Modulwechsel auch im bestehenden Modulverbund ohne Auswirkung auf benachbarte Module.
- **Universelle Integration** - unterbrechungsfreier Systembus: sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert.
- **Maximale Verfügbarkeit** - Fünf voll-galvanisierte und teil-vergoldete Twinbogenkontakte stellen eine dauerhafte Kontaktierung zum Tragschienenbus sicher. THR-Lötflansche sorgen für eine stabile Verbindung zur Leiterplatte.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CH20M BUS-PROFIL TS 35X ...	Ausführung
Best.-Nr.	1248190000	OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 500 mm, Breite: 25.1
GTIN (EAN)	4050118053258	mm
VPE	5 Stück	
Typ	CH20M BUS-PROFIL TS 35X ...	Ausführung
Best.-Nr.	1248180000	OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 250 mm, Breite: 25.1
GTIN (EAN)	4050118053265	mm
VPE	5 Stück	
Typ	CH20M BUS-PROFIL TS 35X ...	Ausführung
Best.-Nr.	1248210000	OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 750 mm, Breite: 25.1
GTIN (EAN)	4050118053241	mm
VPE	5 Stück	

Empfohlenes Reflow-Lötprofil**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

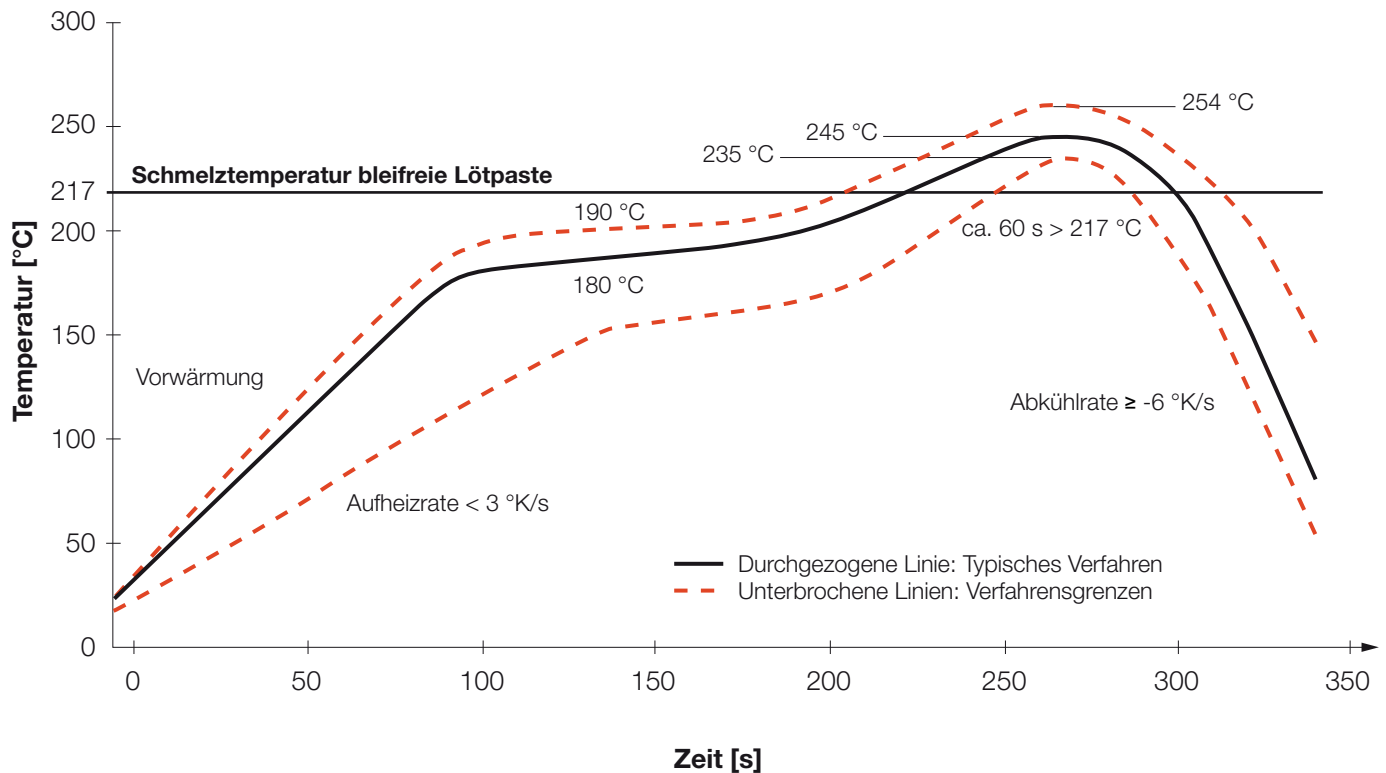
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Reflow Lötprofil**

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt $\leq +3 \text{ K/s}$. Parallel dazu wird die Lotpaste 'aktiviert'. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüssen auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei $\geq -6 \text{ K/s}$ härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.